

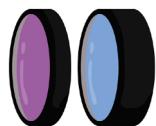
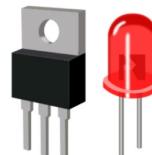
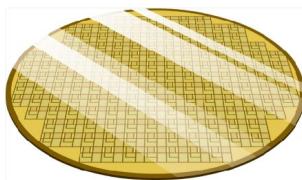
研究・開発・試作

光学・半導体・電子部品

受託蒸着・開発

【蒸着技術開発・薄膜開発・プロセス開発】

用途



各種条件	主な内容
主要プロセス	抵抗加熱 電子銃 イオンアシスト イオンプレーティング
加工膜厚	数nm～数μmまで
積層可能数	1層～100層 2物質交互層可能
処理対象物	ガラス 樹脂 金属 Siウエハ GaAsなど
蒸着条件	真空間度 加熱温度 イオンクリーニング等 応相談

メリット

- スパッタ方式より、蒸着材料費・加工費用ともにコスト低減可能
- スパッタ/メッキより、使用可能材料豊富
- お客様希望条件にて加工実施
- 加工条件やプロセスなど情報開示可能

蒸着物質

- 無機物各種:酸化物/フッ化物/窒化物
- 金属等(毒物劇物/腐食物質等以外)
- 有機物(フッ素系撥水等)
- その他、お客様希望の各種物質